

北京耐威科技股份有限公司 关于全资子公司股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 25 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司北京瑞通芯源半导体科技有限公司申请委托贷款的议案》，同意公司全资子公司北京瑞通芯源半导体科技有限公司（以下简称“瑞通芯源”）向北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”）申请人民币 7 亿元的委托贷款，由亦庄国投委托中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“建设银行”）向瑞通芯源发放该笔贷款。

瑞通芯源申请该笔委托贷款的金额为人民币 7 亿元，期限为 12 个月，利率为 6.5%，将用于投入 8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目。公司及控股股东拟为瑞通芯源此笔委托贷款提供连带责任担保；同时公司拟以持有的瑞通芯源 100% 股权为此笔贷款提供质押担保，公司控股子公司纳微矽磊国际科技（北京）有限公司拟以持有的土地使用权为此笔贷款提供抵押担保。瑞通芯源申请该笔委托贷款的详细条件以相关方签订的最终合同为准。

二、质押标的公司的基本情况

- 1、统一社会信用代码：91110302339754151E
- 2、名称：北京瑞通芯源半导体科技有限公司
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲 5 号 3 号楼 6 层 601-5 室
- 5、法定代表人：杨云春

6、注册资本：50000.00 万人民币

7、成立日期：2015 年 04 月 28 日

8、营业期限：2015 年 04 月 28 日至 2045 年 04 月 27 日

9、经营范围：半导体、集成电路的技术开发、技术服务、技术咨询；集成电路功能设计；投资；投资管理；投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

瑞通芯源为公司的全资子公司，目前为公司 MEMS 工艺开发及晶圆制造业务的持股及投资平台。

三、交易对象及交易内容

（一）交易对象

1、统一社会信用代码：91110302684355290F

2、名称：北京亦庄国际投资发展有限公司

3、类型：其他有限责任公司

4、住所：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 56 幢

5、法定代表人：芦永忠

6、注册资本：959396.98 万元人民币

7、成立日期：2009 年 02 月 06 日

8、营业期限：2009 年 02 月 06 日至 2025 年 02 月 05 日

9、经营范围：投资管理、投资咨询；自有办公用房出租。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司与亦庄国投不存在关联关系。

（二）交易内容

瑞通芯源向亦庄国投申请人民币 7 亿元的委托贷款，期限为 12 个月，利率为 6.5%，由亦庄国投委托建设银行向瑞通芯源发放该笔贷款。

本次交易内容为公司将持有的瑞通芯源 100%股权质押给亦庄国投，为瑞通芯源此笔人民币 7 亿元的委托贷款提供质押担保，质押期限自登记之日起至主合同和股权质押协议完全履行完毕或终止时终止（以时间较晚者为准）。

四、交易目的和对公司的影响

亦庄国投是知名国有投融资服务集团，瑞通芯源向其申请此笔委托贷款，有利于部分解决公司“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”的资金需求，尽快启动建设相关工程。

本次公司将持有的瑞通芯源 100%股权质押给亦庄国投，目的是为瑞通芯源此笔委托贷款提供质押担保。本次担保有利于委托贷款的顺利实施，从而部分满足公司本土 MEMS 业务发展的资金需求，符合公司发展战略，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、交易最新进展

2017 年 11 月 9 日，北京市工商行政管理局北京经济技术开发区分局受理了公司本次股权质押申请，并出具了“(京经)股质登记设字[2017]第 00005508 号”《股权出质设立登记通知书》，具体登记事项如下：

- 1、质权登记编号：91110302339754151E_0001
- 2、出质股权所在公司：北京瑞通芯源半导体科技有限公司
- 3、出质股权数额：人民币元 50000.0 万元
- 4、出质人：北京耐威科技股份有限公司
- 5、质权人：北京亦庄国际投资发展有限公司

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《股权质押协议》；
- 3、《股权出质设立登记通知书》。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 9 日